



产品技术参数表
QSi 108-93-1
高导热灌封硅胶材料

产品描述

QSi 108-93-1 是一种用于电子类灌封的 100% 固体弹性硅胶，具有很高的热传导性能，同时也是具有高硬度和稳定的结构性双组分材料。

主要性能

- 100% 固体 – 无溶剂
- 良好的物理性能
- 高导热系数

典型性能

固化前性能

	“A” 组分	“B” 组分
粘性, cps	29400	31200
外观	灰色	灰色
比重	2.78	2.79
混合比率		1:1
灌胶时间		7 hrs

固化条件(材料在一定条件下的固化时间表):

150°C 下 20 分钟; 100°C 下 45 分钟; 23°C 下 24 小时

固化后性能 (150°C 下 15 分钟固化)

硬度 (丢洛修氏 OO)	70
抗拉强度,psi	500
延伸强度, %	62
热膨胀系数, °C	18×10^{-5}
有效温度范围, °C	-55to232 °C
绝缘强度 V/mil	500
绝缘常数 1KHz	5.0
耗散因数, 1KHz	0.004
体积电阻率 Ohm-cm	1.0×10^{15}

阻燃性 UL 94 *

3.0mm	V-0
1.5mm	V-1
<u>热传导系数</u>	
W/m K	1.90

使用方法

A、B 双组分混合前要充分搅拌。

手动混合

混合相同体积或重量的 A 组分和 B 组分后搅拌直到完全混合。搅拌时应小心以减少其中滞留空气。

自动设备混合

使用可混合 A、B 双组分已经调好 1: 1 混合比的设备混合。材料一旦混合后有 480 分钟的操作时间。

储存和有效期

QSil 108-93-1 应该存放在 25°C (77°F) 下未开封的原包装内。如果可以一直存放在此种环境中，产品有效期为 12 个月。